



董總 马来西亚
华校董事联合会总会
United Chinese School
Committees' Association
of Malaysia
DONG ZONG



编号: DZ/PR045/2020/奖贷

董总新闻稿

2020年11月27日

为培育云端资讯化专业人才 董总联合高师大提供全额奖学金

为永续经营“董总云端智慧教育平台”，董总联合国立高雄师范大学，特提供兩名专项师培全额奖学金予有兴趣者，前往台湾高师大攻读“软体工程与管理学系”学士学位。

在此专项师培全额奖学金计划下，高师大将提供四年的大学学杂费全免奖学金，而董总在获得热心企业的资助下，将提供兩份大学生生活奖学金，作为大学四年的生活補助费用，以助学生安心就学，日后到董总服务，协助推动华文独中资讯化教育发展的工作。

2020年1月初，高师大的人工智能产学中心团队代表到访董总交流，特别针对董总与华文独中的需求，打造了“董总云端智慧教育平台”，整合独中教育资源，对董总推动统考考务系统和独中教育资讯化的发展，将发挥重要作用。

有关师培全额奖学金，欢迎持有华文独中高中统考证书及大马高级教育文凭（STPM）的毕业生申请，截止日期为今年12月15日。申请者必须经过面试与遴选，获得此全额奖学金者，必须与董总签约，四年学成毕业后，必须到董总服务。

凡是获得上述师培全额奖学金者，其大学第一年的学习成绩须达到高师大的规定，并经大学有关单位审核后，始可续续获得下一学年的奖学金。

有意申请者，请浏览董总学务处学生事务局网页内的奖贷助学金资讯网页（student.dongzong.my）进行线上申请工作，再将大学奖学金申请表以及证件资料电邮至 scholarship@dongzong.my。若有任何疑问，请联系奖学金业务负责人林冰冰小姐，电话：03-8736 2337 分机 229，咨询时间为星期一至星期五，上午9时至下午4时30分。



Persekutuan Persatuan-Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia (PPM-001-10-10121955)

Blok A, Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia ☎ 603 - 8736 2337 📠 603 - 8736 2779 🌐 www.dongzong.my 📧 support@dongzong.my